

2) 業績概要

平成12年12月31日に終了しました平成13年3月期第3四半期連結業績についてご報告いたします。

当第3四半期連結業績は、売上高が1,801億74百万円(前年同期比4.3%増)、営業利益は180億83百万円(同4.5%減)、税引前利益は155億52百万円(同13.3%減)、当期純利益は103億92百万円(同14.5%減)、一株当たり当期純利益は78円08銭となりました。

当期間における、対米ドル及びユーロの平均円レートは、110円、96円と、前年同期に比べ、米ドルは5%円安、ユーロは12%の円高となりましたが、米ドルの割合がユーロよりも大きかったため、円換算後の業績を押し上げました。この為替による影響額は、売上高で約22億円、営業利益で約13億円となります。

< 部門別売上高の概況 >

部門別の売上高については、今期首より売上高内訳の見直しと、一部製品区分の名称変更を実施しており、この新しい区分にて部門別売上高の概況をまとめております。

電子素材部品部門

電子素材部品部門合計では、前年同期比8.0%増の1,419億22百万円となりましたが、製品毎の概況については以下の内容となります。

電子材料製品

積層チップコンデンサは、携帯電話の市場拡大に加え、PC関連及びデジタル関連機器向けも好調で、売上高を大きく伸ばしました。また、フェライトコアも、ADSL(非対称デジタル加入者回線)等の情報通信用コアの好調により、売上高は堅調でした。

しかしながら、対前年比で大きく売上高を伸ばしております積層チップコンデンサは、対象となる市場全般の伸びに減速感が見られ、その影響で当第2四半期と比較しますと、売上高はほぼ横ばいとなっております。これらにより、電子材料製品の売上高は、前年同期比30.1%増の560億62百万円となりました。

電子デバイス製品

高周波部品は、携帯電話市場の拡大に合わせ増産体制をとった高周波モジュール、VCO、高周波コイルが寄与し、売上高を大きく伸ばしました。インダクティブ・デバイスは、AV、OA、通信各市場における需要の拡大により、コイル製品が売上高を伸ばしました。また、OA、通信市場を中心に市場が拡大したことで、EMC(電磁環境適合性)対策部品の売上高が拡大しました。

但し、インダクティブ・デバイスにおいても、積層チップコンデンサ同様、対象となる市場全般の伸びに減速感が見られ、その影響で当第2四半期と比較しますと、売上高は微減となっております。この結果、電子デバイス製品の売上高は、前年同期比19.3%増の393億4百万円となりました。

記録デバイス製品

第2四半期後半から出荷を開始した、面記録密度の高いGMRヘッドの新製品における技術的な難しさに起因した生産歩留りの悪化、ならびに昨年9月中旬の大雨により、製造工程が6日間停止したことによる影響が、第3四半期にも残り、出荷数量が伸び悩みました。

また、歩留りについては、当初の改善計画通り、第3四半期後半にかけて回復してきたものの、昨年11月後半から顕在化しているPC、ならびにPC関連製品の市場減速の影響から一部の得意先において生産調整がありました。この結果、前年同期比21.5%減の395億37百万円の売上高になりました。

IC関連その他製品

LAN用およびセット・トップ・ボックスのモデム用半導体の堅調な売上高に加え、当四半期には、電波暗室の売上高も計上されたため、前年同期比39.8%増の70億19百万円の売上高になりました。

記録メディア・システムズ製品部門

CD-Rは、需要拡大により数量ベースでは増加したものの、需給環境の悪化から売価ダウンが激しく、売上高は減少しました。また、オーディオテープは、総需要の減少による数量減、ビデオテープは、数量ベースではほぼ前年比横ばいを維持できたものの、売価ダウンの影響があり、それぞれ売上高が減少しました。この結果、前年同期比7.6%減の382億52百万円となりました。

< 地域別売上高の状況 >

国内においては、記録メディア・システムズ製品部門ならびに記録デバイス製品の売上高減少を、積層チップコンデンサを中心とした電子材料製品ならびに電子デバイス製品の好調でカバーしきれず、前年同期比0.8%減の610億26百万円となりました。

欧州地域は、GSMシステムを中心とした携帯電話向けの積層チップコンデンサや高周波部品が好調で、前年同期比24.3%増の302億18百万円となりました。

アジア他の地域は、国内同様、記録デバイス製品の売上高減少を、積層チップコンデンサを中心とした電子材料製品ならびに電子デバイス製品の好調でカバーしきれず、前年同期比9.2%減の552億54百万円となりました。

米州地域は、電子材料製品ならびに電子デバイス製品の好調に加え、記録デバイス製品において、昨年3月末にヘッドウェイ・テクノロジー社を買収したことにより、売上高が増加し、前年同期比29.1%増の336億76百万円となりました。

この結果、海外売上高の合計は、前年同期比7.1%増の1,191億48百万円となり、連結売上高に対する海外売上高の比率は前年同期の64.4%から1.7ポイント増加し、66.1%となりました。

〔平成 13年 3月期の業績見通し〕

平成 13年 3月期の連結業績見通しにつきましては、下記の通りであります。
なお、見通し作成に当たっては、次の点を考慮して行っております。

- * 前提となる対米ドル平均市場円レートは、上期実績 107円、下期見込み 113円で、前回の下期見込み 105円に対し、円安を想定しております。
- * (連結売上高) 前回 11月時点での見通しと比べ、
電子材料製品、電子デバイス製品においては、携帯電話メーカー並びにPC関連メーカーの在庫調整の影響を受け、主要製品である積層チップコンデンサ、高周波部品を中心に下方修正をしております。
記録デバイス製品においては、昨年12月頃からの急速なPC市場の落ち込みから、HDDの在庫調整が始まり、その影響から下方修正しております。
これにより、連結売上高は、前回見通しを下回るものと見込んでおります。
- * (連結営業利益) 前回11月時点での見通しと比べ、
主要製品の売上高下方修正に伴い、営業利益におきましても下方修正をしております。

〔連結業績見通し〕

	今回見通し	前年比 増減率	平成12年11月時点での見通し
売上高	700,000 百万円	3.8%	720,000 百万円
営業利益	66,000	-11.5%	75,000
税引前利益	72,000	-1.9%	86,000
当期純利益	49,000	-3.4%	59,000

【見通しに関する留意事項】

この資料に記載されている平成 13年 3月期の業績見通しは、当社及び当社グループ会社が現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいております。従いまして、これらの業績見通しにのみを依拠することは控えるようお願いいたします。実際の業績は、様々な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。

当社の主たる事業活動領域であるエレクトロニクス・ビジネス市場は変動性が激しく、また、当社は国内だけでなく海外においてもビジネスを行っているため、技術、需要、価格、競争状況、経済環境の変化、為替レートの変動、その他の多くの要因が業績に影響を与えることがあります。